

Investor Relations 2025

Global Dream Company,
Realizing Dreams with the World

HANA MICRON INC.



2025. 1Q 실적 반영



Investor Relations 2025

Table of Contents

- 01. 회사개요
- 02. 사업영역
- 03. Business Performance
- 04. Affiliates
- Appendix

Disclaimer

본 자료는 투자자를 대상으로 실시되는 presentation에서 정보를 제공하기 위한 목적으로 하나마이크론(이하 “회사”)이 작성한 것이며 본 자료를 복사, 재생, 배포 또는 게재하거나 다른 목적으로 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 presentation에 참석하는 경우 위 내용에 대한 동의로 간주되며 만일 위 사항을 위반하는 경우 동시에 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’의 위반에도 해당 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별적인 확인 절차를 거치지 않은 정보입니다. 이는 과거가 아니라 향후 예상되는 미래의 회사 경영현황 및 재무실적을 의미하는 것으로서, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어가 사용된 경우는 “예측정보”를 가리킵니다.

“예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 영향을 받을 수밖에 없어 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제의 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려하여 작성된 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 투자자에 대한 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 과실 등의 여부를 불문하고 여하한 책임도 부담하지 아니합니다. 본 자료는 주식의 모집 또는 매매의 청약에 대한 권유에 해당되지 아니합니다.



Global Dream Company,
Realizing Dreams with the World
HANA MICRON INC.



Chapter 1.

회사개요

- 01. Introducing
- 02. Value Chain
- 03. Business Area

01. Introducing



반도체 패키징 및 테스트 전문기업



최창호 회장

2001.08 ~ 2017.03
하나마이크론 대표이사
1999.08 ~ 2001.05
삼성전자 멕시코 복합단지장
1995.12 ~ 1998.07
삼성전자 반도체 관리본부장
1987.11 ~ 1992.03
삼성반도체 관리이사



이동철 대표이사

2019.03 ~ 현재
하나마이크론 대표이사
2015.03 ~ 2018.12
삼성SDI 기획팀장, 구매팀장
2012.01 ~ 2014.12
SMD 기획팀장
1984.12 ~ 2011.12
삼성전자 (SEJ) 반도체 사업부장
외)

General Description

회사명	하나마이크론
대표이사	이동철
설립일	2001년 8월 23일
자본금	331억 원 (2025년 3월 말)
매출액	12,507억 원 (2024년 연결재무제표)
임직원수	730명 (2025년 3월 말)
사업영역	반도체 패키징 및 테스트
소재지	• 본사 : 충남 아산시 음봉면 원남리 95-1 • 판교 : 경기 성남시 분당구 삼평동 613 • 미국법인 : 1900 McCarthy Blvd. #210 Milpitas, CA95035, U.S.A <HMA>

02. Value Chain



반도체 후공정 패키징 및 테스트 전문기업

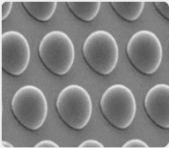
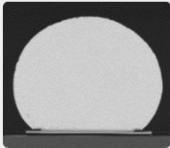
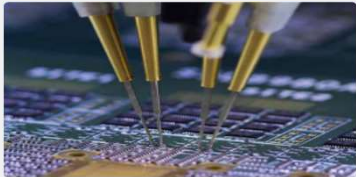
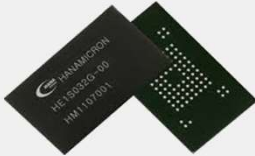


* OSAT—Outsourced Semiconductor Assembly & Test

03. Business Area



Full Turnkey OSAT Service

Bump	Wafer Test	Assembly	Final Test	Module @ 해외법인
- Solder plate - Ball Drop - Cu Pillar - Thick RDL	Wafer Test (Probe Test)	- Wire Bonding - Flip Chip / BGA/ FBGA - WLP - Flexible PKG - SiP, SoC	- RF Test - SOC Test - Logic Test - Analog Test	- Module Assembly (SMT) - Elec Test - Application Test
 			 	 

Customer



Global Dream Company,
Realizing Dreams with the World
HANA MICRON INC.



Chapter 2.

사업영역

01. Strategy

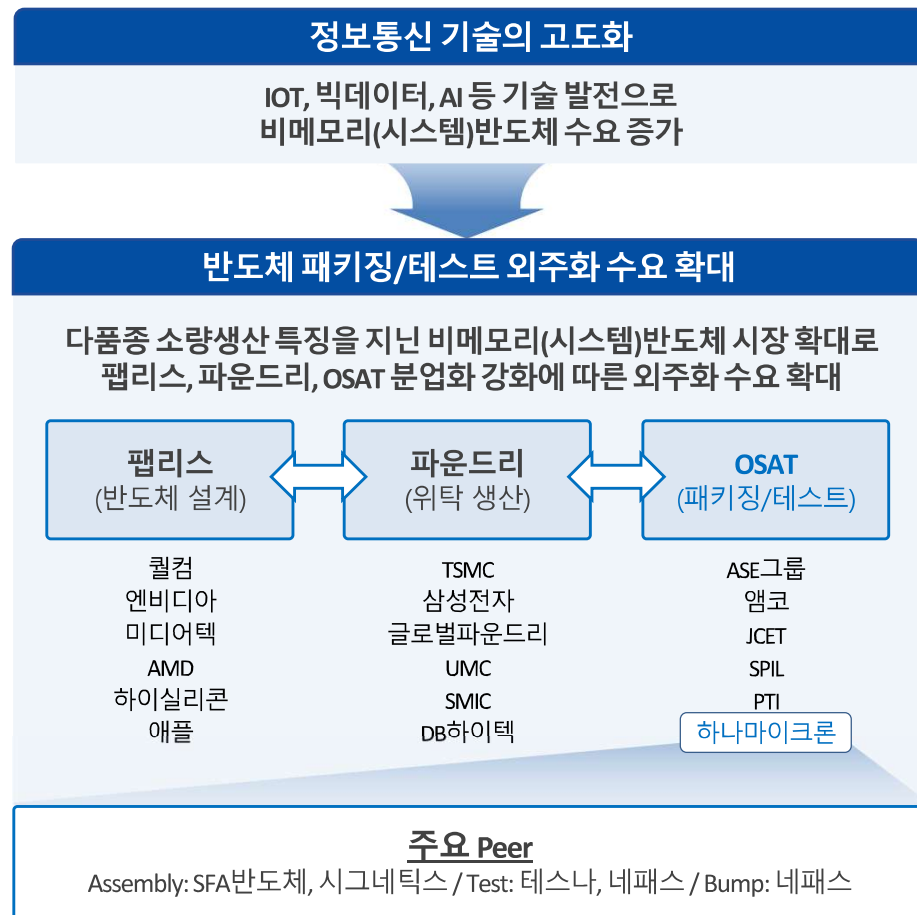
02. Assembly(Memory / Non-Memory)

03. Test

01. Strategy



고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징/테스트 사업 확대



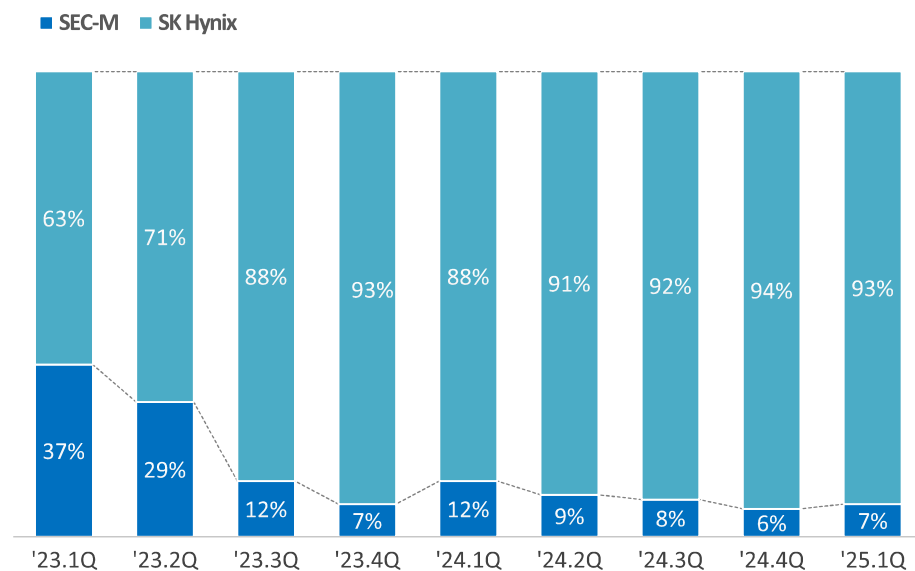
02. Assembly (Memory)



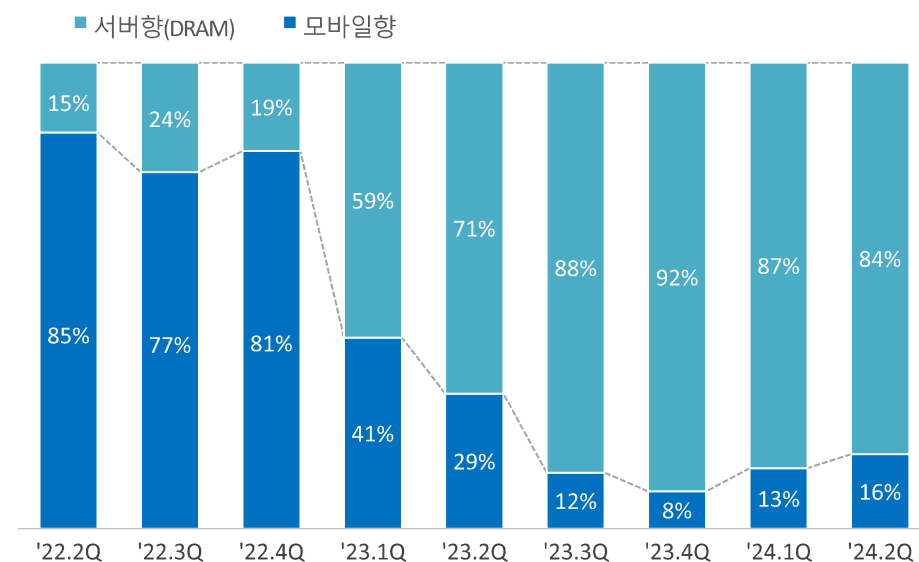
메모리 매출/제품 확대 및 CAPA UP 확보

- 5G 전환에 따른 메모리 제품에 대한 수요의 지속적 증대 전망
- 2022년 하반기 이후 고객사의 재고 조정으로 인한 가동률 저하
- 2024년 이후 메모리 업황 개선에 따른 가동률 회복 기대
- 2024년 2분기 이후 서버向 DRAM 신제품 양산 개시

Memory 제품 고객사별 매출액 비중



Memory 제품 Application별 매출액 비중



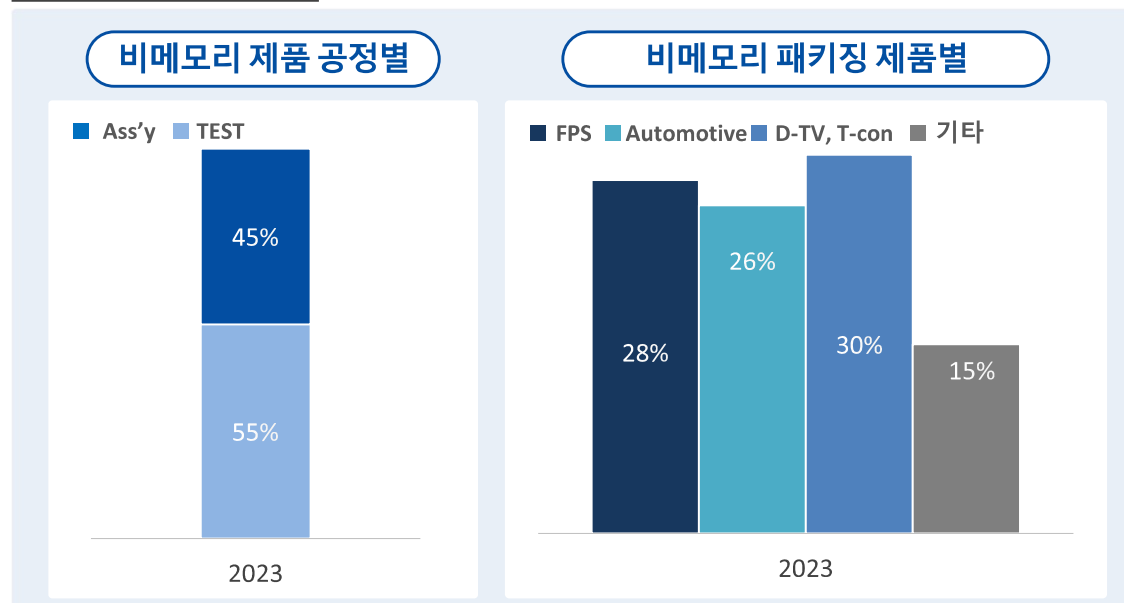
02. Assembly (Non-Memory)



다양한 비메모리 패키징 제품 확장을 통한 매출 확대

- Automotive향 관련 제품 및 고객의 다양화를 통한 매출 성장 기대.
- Automotive 향 관련 지속적인 기술 개발을 통해 Automotive 비즈니스를 확장하고자 함.
- 지문인식센서의 고객사별 M/S는 꾸준히 확보하고 있으며, 이를 통한 기본적인 매출액 확보
- 기타 다양한 분야의 고객사 추가 확보를 통한 비메모리 패키징 비즈니스의 확장 기대

비메모리 매출 비중



비메모리 패키징 차기 기술 보유

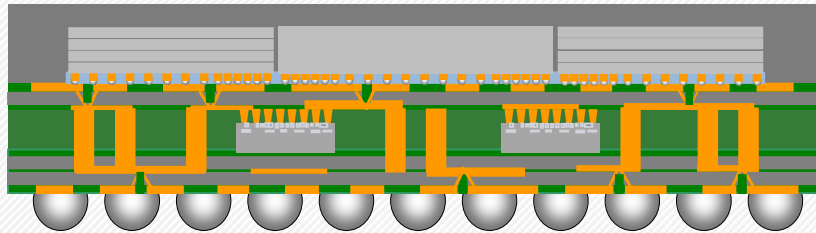
제품	기술	적용 제품	Biz 방식
Wafer Level Package	Thick RDL + Thermal dissipation	5G Quick Charger	OSAT
FPS Package	Thin Shape + Flexible PKG	Smart Card	OSAT
VCSEL SIP	Integration + Thermal dissipation	3D Sensor	ODM
Sensor Module	Flexible PKG + Signal Processing	Medical Patch	ODM

[참고자료] Assembly (Advanced 2.5 Semiconductor Packaging)



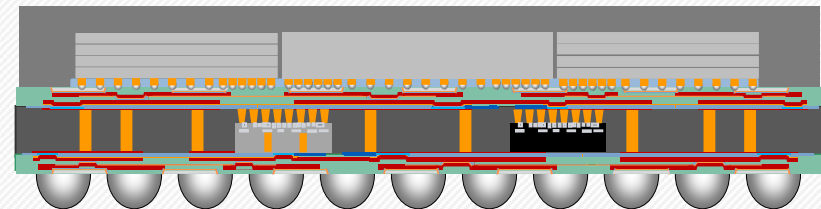
- HIC™ (Heterogeneous Integrated Chip) technology enables advanced 2.5D structures.
- It utilizes High IO Density Bridge for long range routing and Advanced Fan Out PKG for short range routing.
- HIC suits for chiplet-based system integration especially in AI applications.

Intel EMIB



Key Tech Si bridge embedded PCB

TSMC LSI / ASE FOCoS
SPIL FOEB / Amkor S-Connect

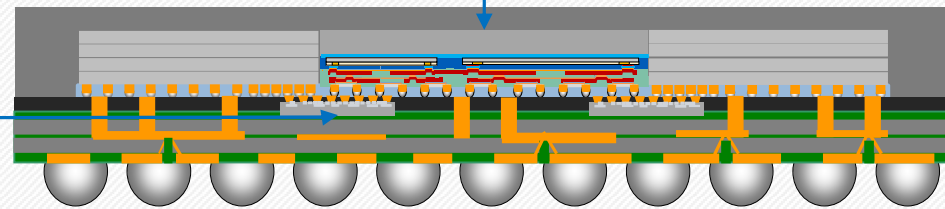


Key Tech Si(w/TSV)&Molded bridge, Double side RDL

"HIC™ (Heterogeneous Integrated Chip)"

Advanced FO (Chiplets)

High IO Density Bridge



Strip level Mold

PCB

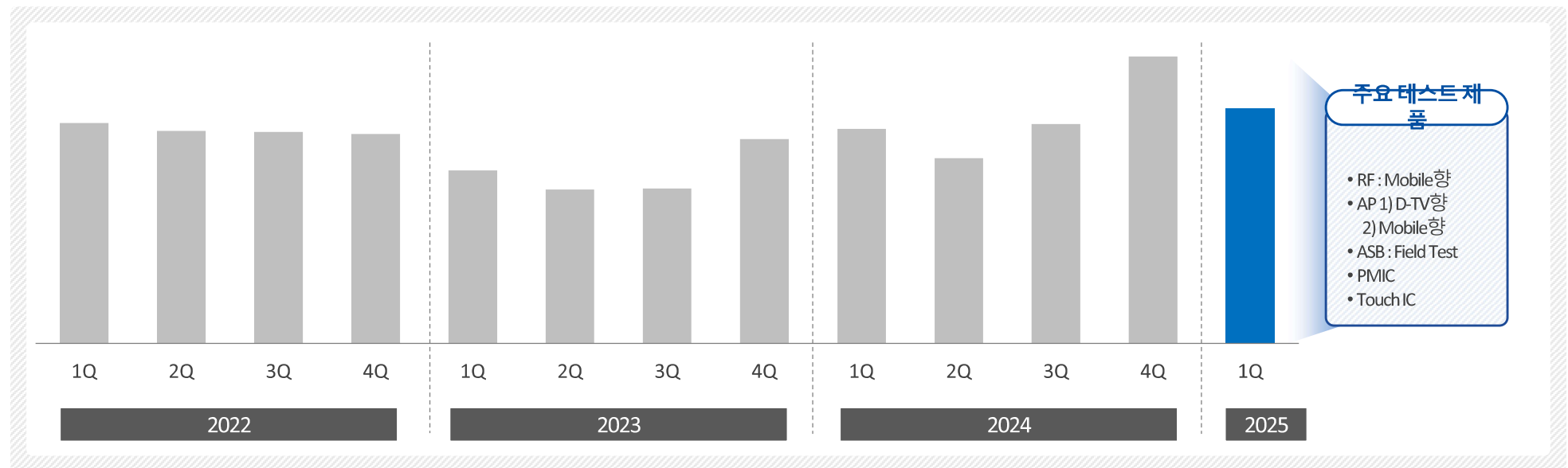
03. Test



비메모리 테스트 매출 본격화

- 다양한 비메모리 Final 테스트 레퍼런스 및 노하우 보유
- Final 테스트 사업의 지속적인 추진 및 제품 다양화를 통한 테스트 사업 확대 기대
- Bump, Assembly, Test 등 반도체 후공정의 Full turn key 수주를 통한 사업 영역 확대 추진 및 독보적 후공정 업체로서의 자리매김 기대

비메모리 테스트 매출 추이



Global Dream Company,
Realizing Dreams with the World
HANA MICRON INC.



Chapter 3.

Business Performance

- 01. 2025년 1분기 경영실적
- 02. 하나마이크론 경영실적(1), (2)
- 03. Customer and Process
- 04. Product
- 05. 주요 해외법인 경영실적(1), (2)
- 06. 하나머티리얼즈 경영실적

01. 2025년 1분기 경영실적



2025년 1분기 매출액 2,128억 원, 영업이익 71억 원 기록

경영 성과 요약(별도)

단위: 억 원

구분	2022	2023	2024	2024	2025	YoY
				1Q	1Q	
매출액	6,081	5,819	7,976	1,774	2,128	41.4%
영업이익	522	167	232	63	71	13.1%
(%)	8.6%	2.9%	2.9%	3.56%	3.36%	-0.2%p
당기순이익	165	(430)	(207)	(259)	(8)	-97.0%
(%)	2.7%	-	-	-	-	-

주: K-IFRS 별도 재무제표

4분기 분석

- 메모리 제품 고객사 재고 조정에 따른 패키징 물량 감소 및 가동률 저하로 영업이익 감소
- 베트남 법인 매출 증대로 인한 베트남향 매출 증가
- 해외법인 환평가 손실 발생에 따른 지분법 손실로 당기순손실 발생



향후 주요 이슈 및 성장 전략

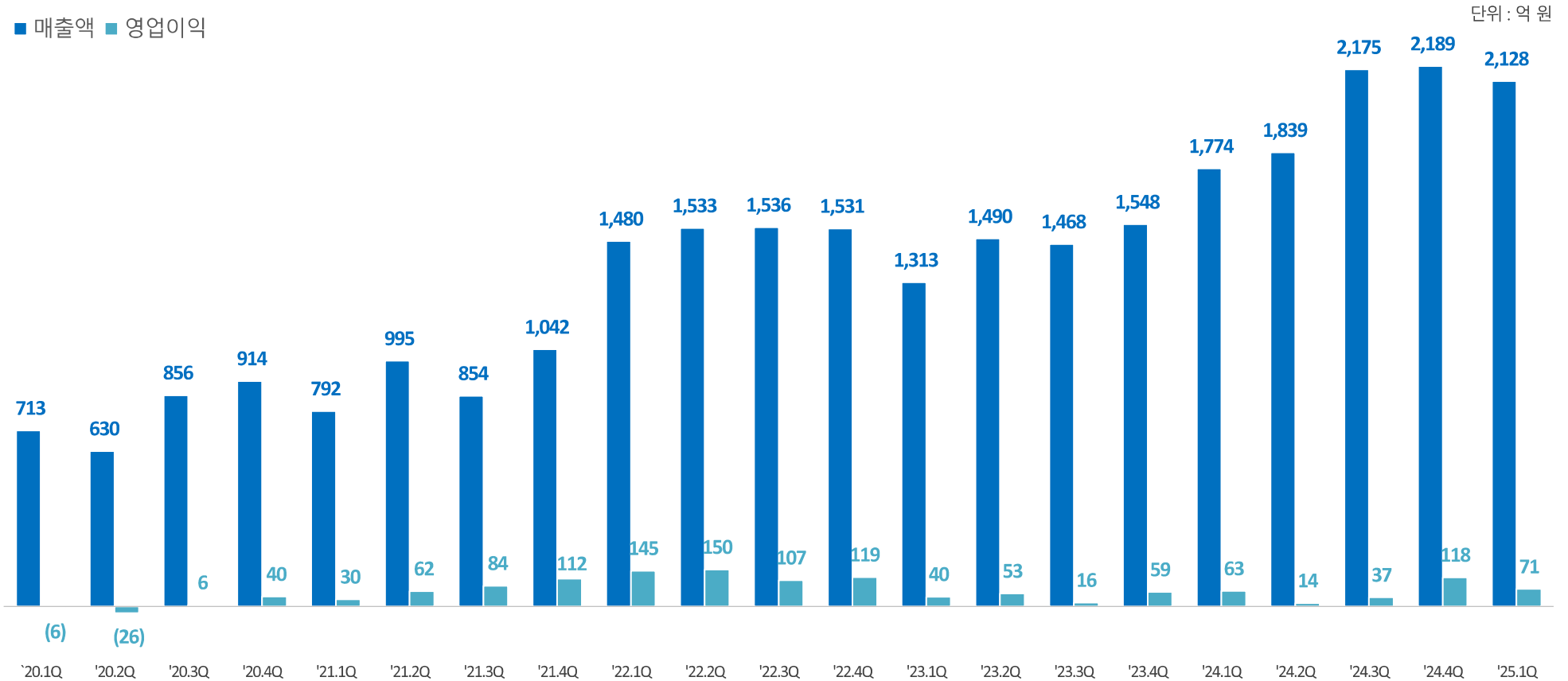
- 메모리 제품의 장기간 하락세가 끝나고 하반기 이후 회복세에 접어들 것으로 전망되며, 이에 따른 패키징 물량 증대 및 가동률 상승으로 인한 매출 및 수익 증대 기대
- 고객사들의 고성능 메모리 반도체 투자 집중으로 legacy 제품의 외주화 확대 등 낙수효과 기대
- HMV는 2동의 양산 개시로 인해 '24년 일시적 수익률 감소 예상



02. 하나마이크론 경영실적(1) 연도별 경영실적



하나마이크론 연도별 경영실적(별도)

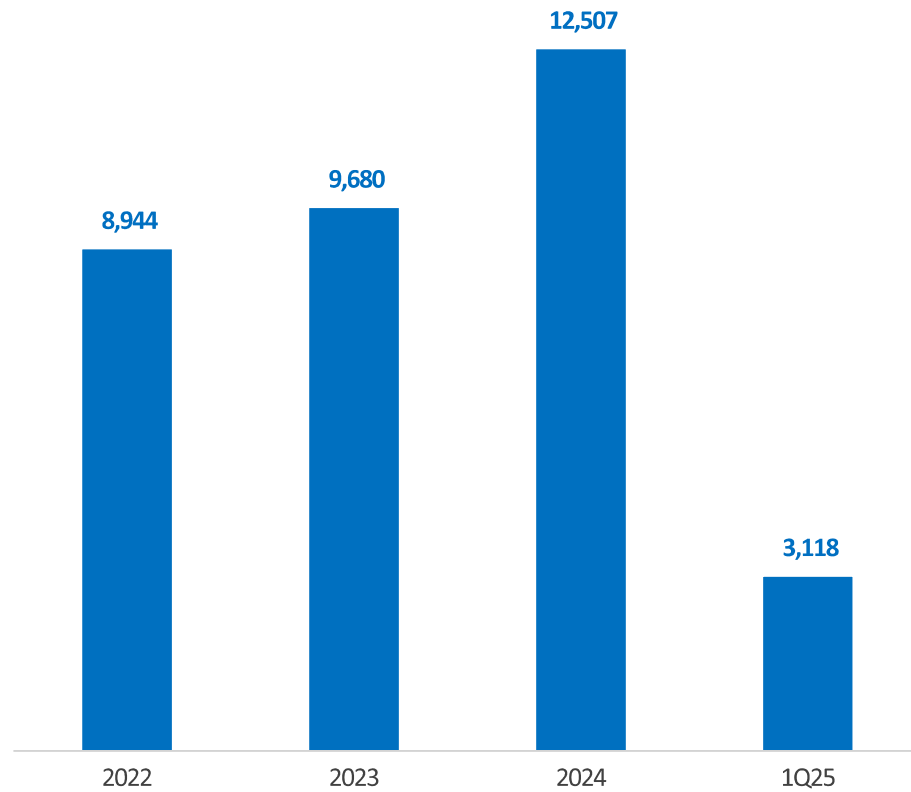


02. 하나마이크론 경영실적(2) 연결 경영실적



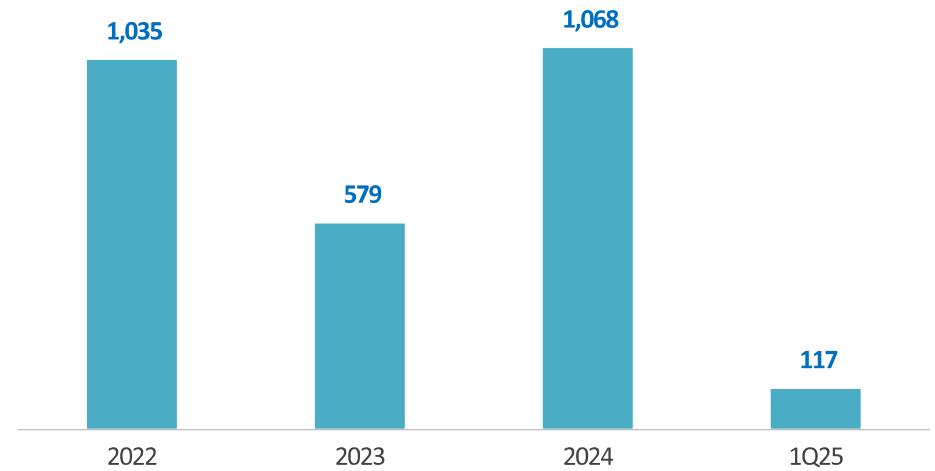
매출액

단위 : 억 원



영업이익

단위 : 억 원



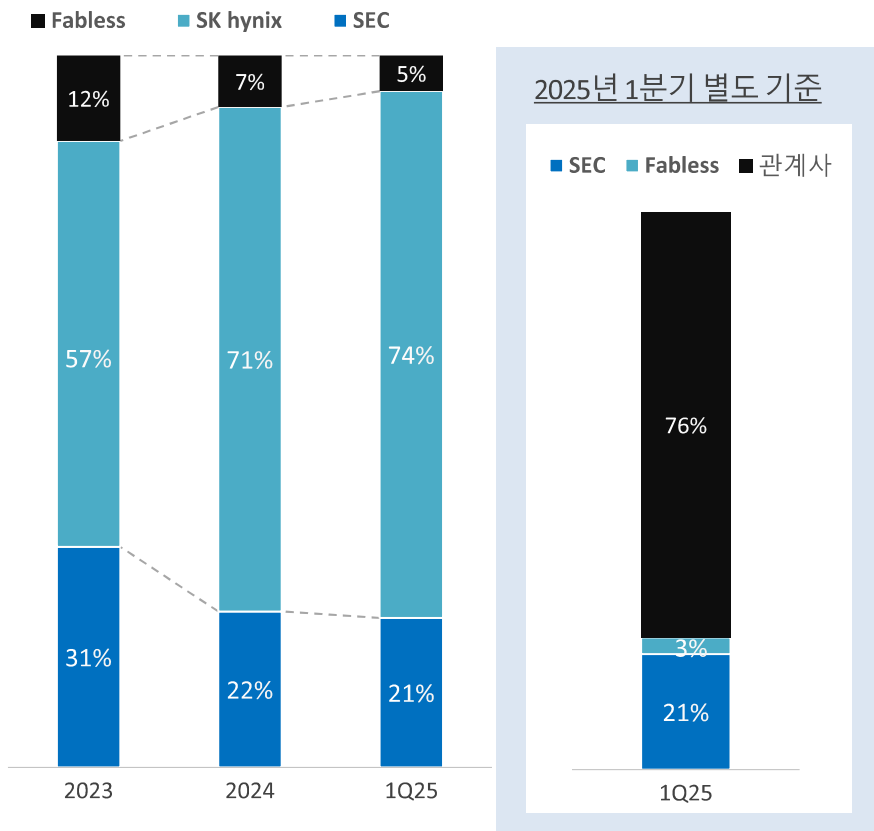
주1: 감사받은 K-IFRS 연결 기준

03. Customer and Process



주요 매출처 및 공정별 매출 비중

주요 매출처 비중

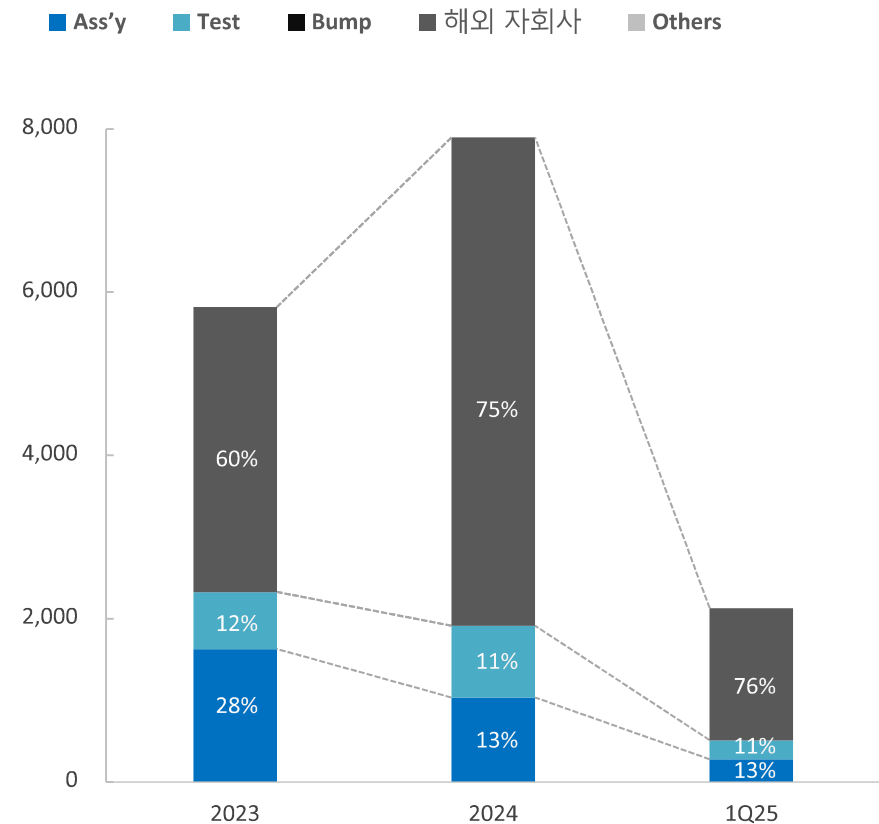


주1: K-IFRS 재무제표 기준

주2: 국내 본사 및 베트남 법인 매출은 별도 매출액에서 베트남 및 브라질 법인항 매출(내부거래 포함) 제외 이후 베트남 법인의 매출을 더한 값

공정별 매출 비중

단위: 억 원

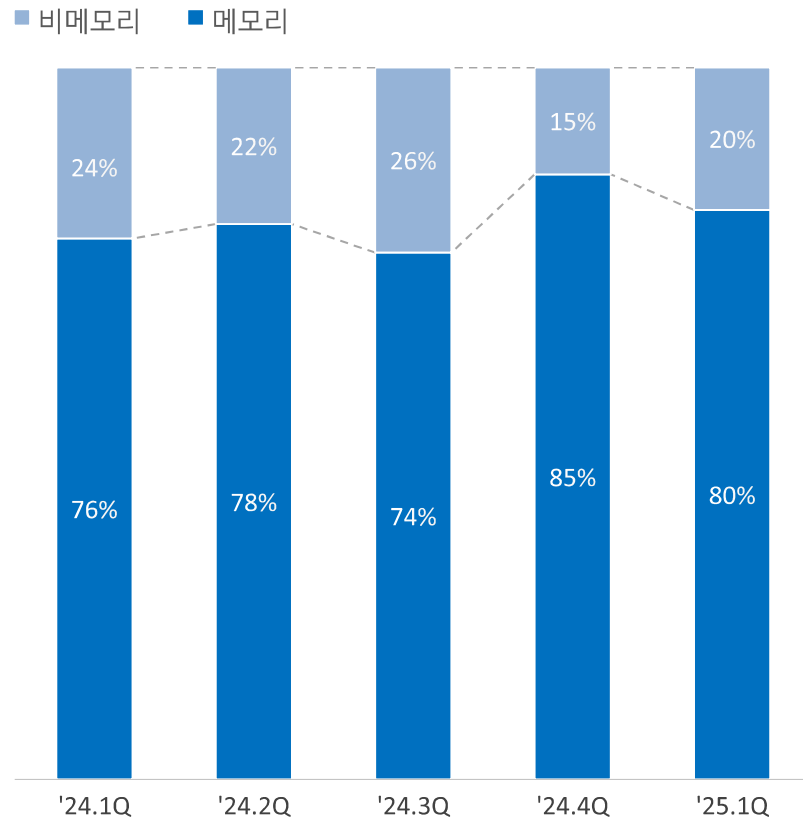


04. Product

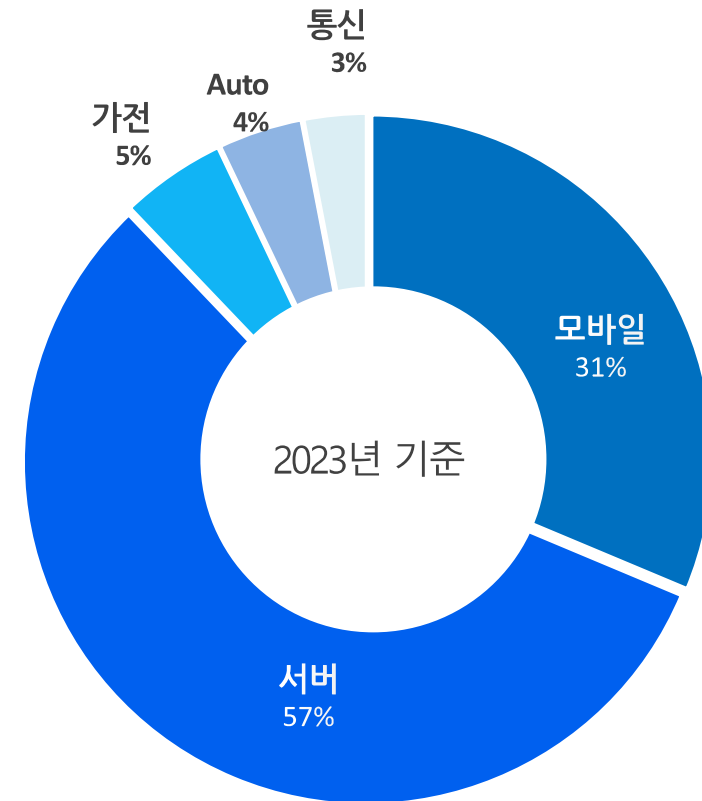


메모리/비메모리 매출 비중

메모리/비메모리 매출 비중(연결)



어플리케이션별 매출 비중



주: 메모리/비메모리 매출 비중(연결)은 해외 자회사(브라질, 베트남) 실적 포함

05. 주요 해외법인 경영실적(1)브라질



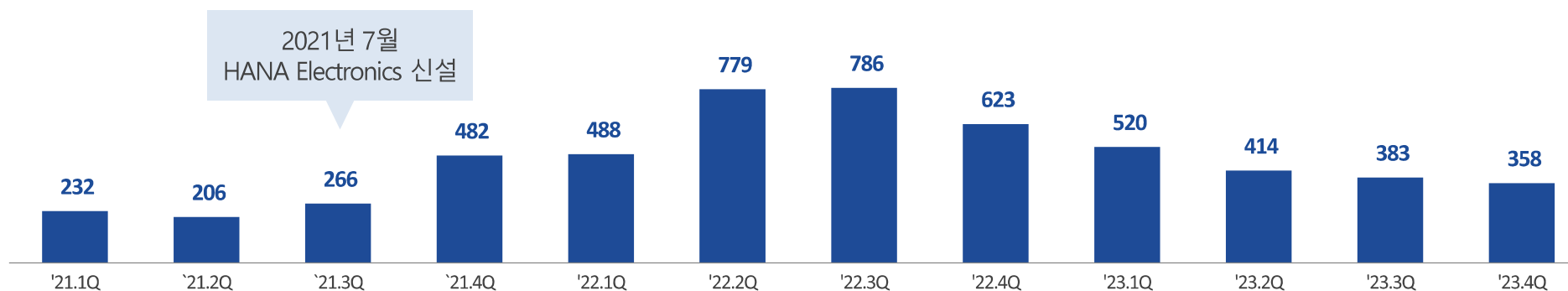
해외 주요 법인, 경영 정상화 및 모바일/PC향 패키지 생산 확대로 실적 개선 전망

주요 실적 코멘트 및 전망

- Mobile 메모리 제품 다변화 및 고객사 신규 유치로 시장점유율 확대 中 (M/S 25% → M/S 50%)
- Module 업체인 HE 신설로 PC向 DRAM 매출 확대 및 하반기 Server向 DRAM 판매 개시
- '23년 메모리 가격 하락 및 물량 감소로 인한 매출액 감소 및 적자 폭 증대
- uMCP, SSD 등 신규 제품 생산 개시
- '23 하반기 이후 SSD 생산 개시에 따른 HE 수익성 개선 예상

브라질법인(HT, HE) 매출액

단위: 억 원



05. 주요 해외법인 경영실적(2) 베트남

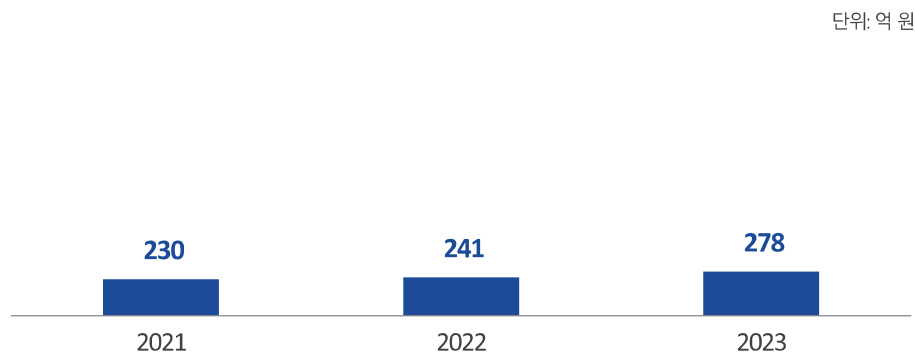


해외 주요 법인, 경영 정상화 및 모바일/PC향 패키지 생산 확대로 실적 개선 전망

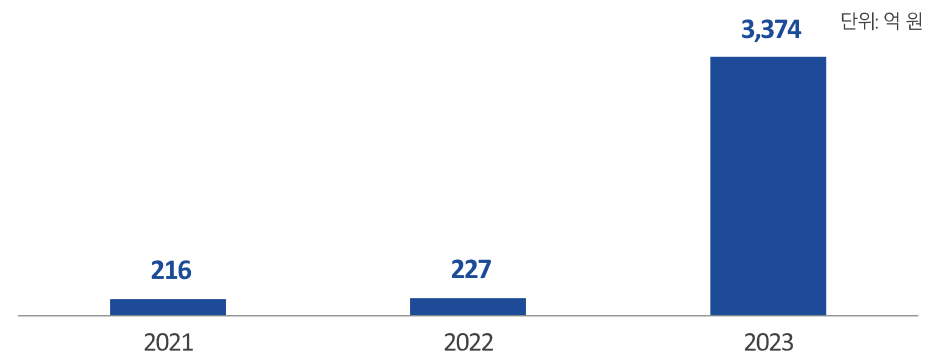
주요 실적 코멘트 및 전망

- '22년 상반기 FPS 제품 V1에서의 집중 생산으로 인한 수익성 개선 예상
- '22년 하반기 이후 V2는 하이닉스 전용 라인으로 생산 개시
- '23년 상반기 이후 V2 매출 증대 및 그에 따른 수익성 개선 예상

HANA Micron Vietnam (V1) 매출액



HANA Micron Vina (V2) 매출액



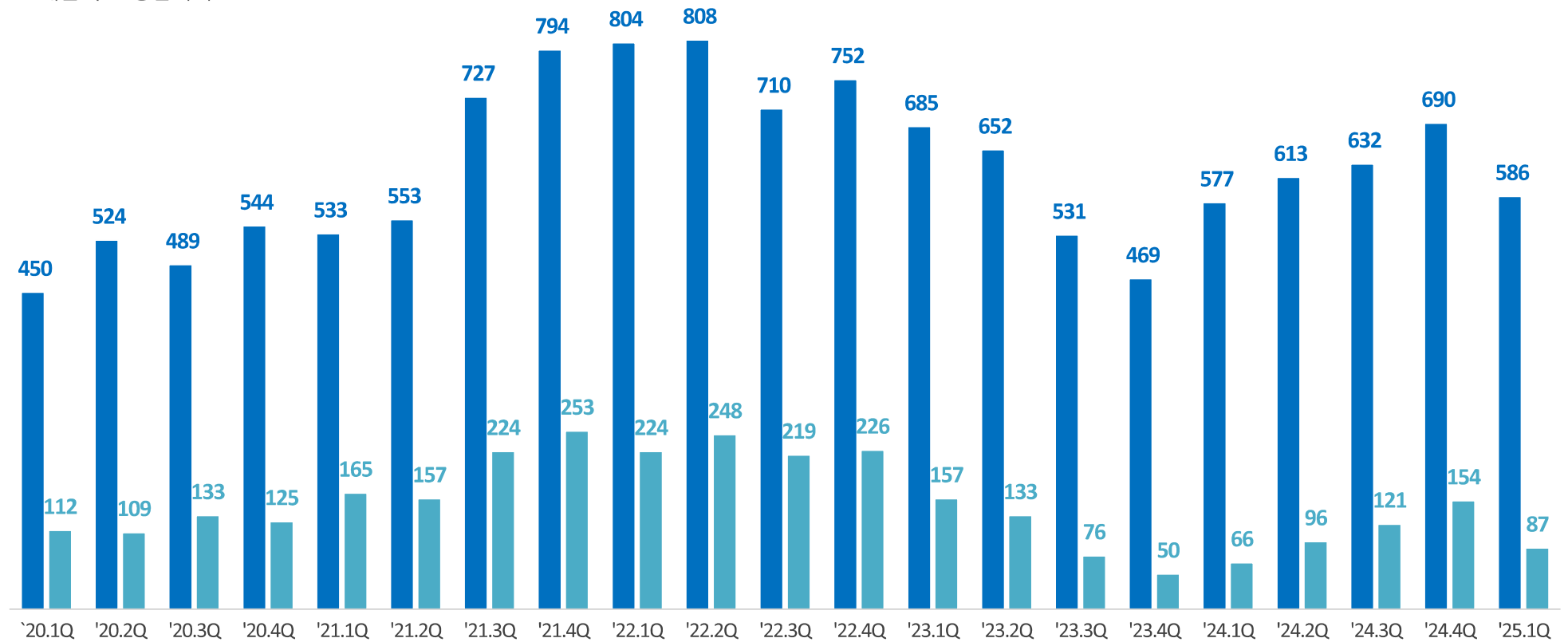
06. 하나머티리얼즈 경영실적 추이



하나머티리얼즈 연도별 경영실적

■ 매출액 ■ 영업이익

단위 : 억 원



Global Dream Company,
Realizing Dreams with the World
HANA MICRON INC.



Chapter 4.

Affiliates

- 01. State of major Affiliates
- 02. Infrastructure(1), (2)
- 03. Major Overseas Affiliates(1), (2)

01. State of major Affiliates

2025. 1Q말 기준

CEO & Related Parties 27.29% Free Float 72.71%							
		32.93%	100%	100%	100%	100%	100%
		하나머티리얼즈	하나더블유엘에스	HANA Micron Vietnam Co., Ltd	HANA Micron Vina Co., Ltd	HT Micron	HANA Electronics
대표이사	김현주	김길백	정원석	정원석	류기태	류기태	
납입자본	98억 원	16.3억 원	USD 5.5M	USD 170.0M	USD 71.27M	USD 5.0M	
설립	2007. 1	2021. 1	2016. 6	2019. 7	2009. 12	2021. 7	
종업원수	720명	69명	166명	1,848명	251명	101명	
소재지	충남 천안 / 아산	충남 아산	Bac Ninh /Vietnam	Bac Giang /Vietnam	Porto Alegre/ Brazil	Manaus/ Brazil	
사업영역	반도체 부품 (Sil.Cathode/ Ring /Ingot)	범프 & 테스트	반도체 패키징 & 테스트	반도체 패키징 & 테스트 모듈 조립 & 테스트	반도체 패키징 & 테스트	모듈 조립 & 테스트 & 완제품 판매	

02. Infrastructure(1) 글로벌 인프라

글로벌 패키징, 테스트 시설 인프라 구축

대한민국, 아산



- 위치: 충남 아산
- 면적: 15,000평
- 주요 제품: 모바일, PC, 가전, 차량용
- 주요 고객사: 삼성, SK하이닉스 등

브라질, São Leopoldo



- 위치: São Leopoldo
- 면적: 3,000평
- 주요 제품: PC, 모바일, 가전용 컴포넌트
- 주요 고객사: 삼성전자, LG전자, 레노버 등

브라질, Manaus



- 위치: Manaus
- 면적: 400평
- 주요 제품: PC, 모바일 용 모듈
- 주요 고객사: 삼성전자, 레노버 등

베트남, Bac Ninh / Bac Giang



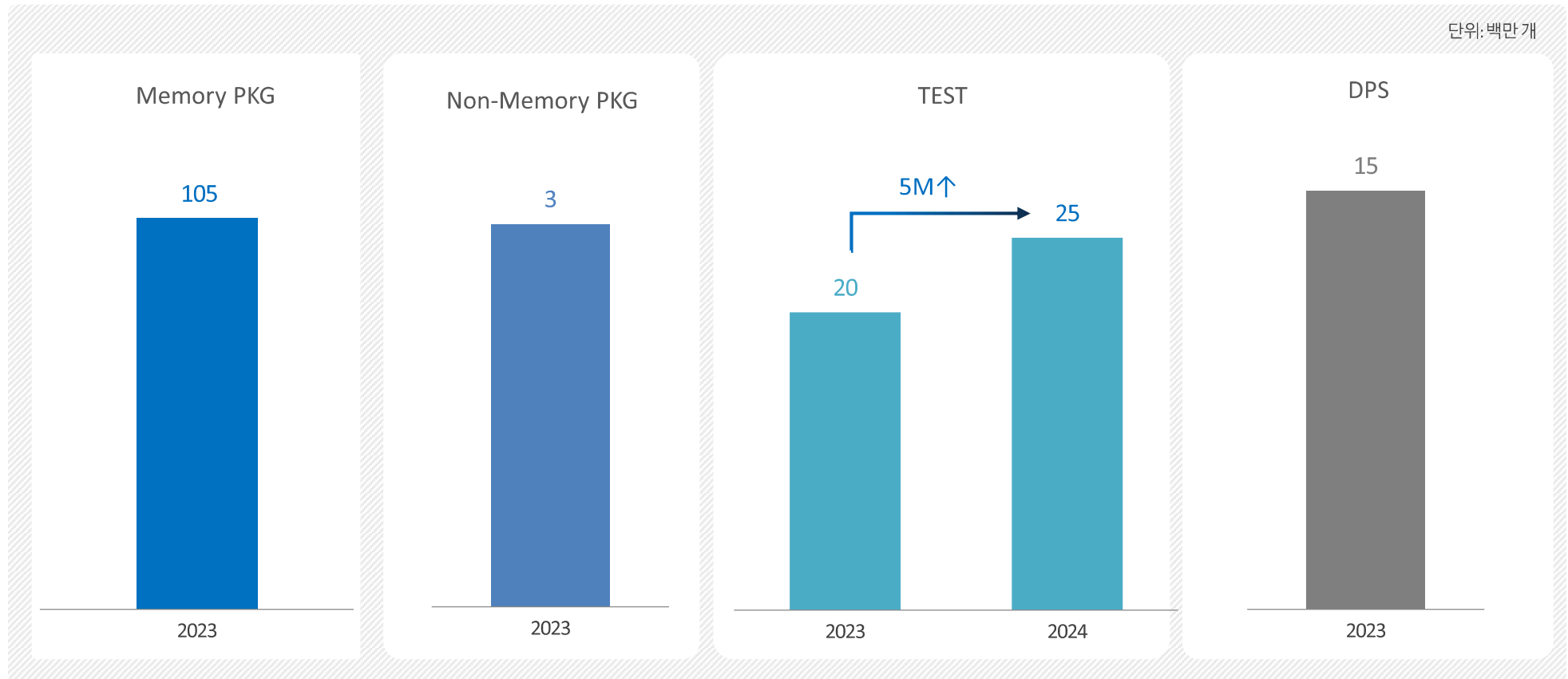
- 위치: HM Vietnam - 박린성 / HM Vina - 박장성
- 면적: HM Vietnam - 700평 / HM Vina - 20,000평
- 주요 제품: FPS
- 주요 고객사: FPC, CT 등
- 주요 제품: 메모리 전제품
- 칩 패키징/테스트, 모듈 조립/테스트
- 주요 고객사: SK하이닉스

02. Infrastructure(2) CAPA



S.LSI Test 증설(4차) → 2024년 4분기부터 본격 가동 예상

하나마이크론 CAPA 현황



주 : Memory / Non-Memory PKG는 Die 기준, TEST는 PKG 기준, DPS는 Wafer 기준.

03. Major Overseas Affiliates(1) 브라질



입지 및 인건비 경쟁력을 보유한 브라질 법인 : Manaus 지역 모듈 제조 법인 신설

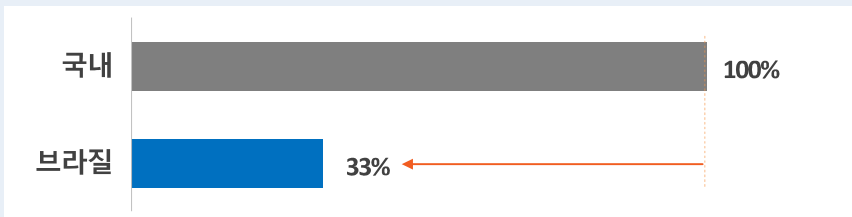
브라질 법인



입지 관련 장점

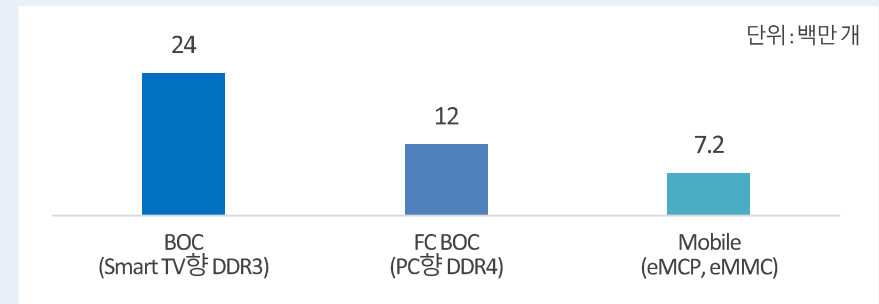
- 비교적 높은 교육 수준의 기술인력 확보 용이 (브라질 최남단, Unisinos 대학 캠퍼스 내 위치)
- 물류 이동 용이 (국제 공항 20분내 위치)
- 주정부 지원의 별도 세제혜택 존재 (연방 정부의 반도체 세제 혜택 외)
- Manaus지역에 신규법인 설립 (LG/삼성으로부터 15분 내외 위치)

저렴한 인건비

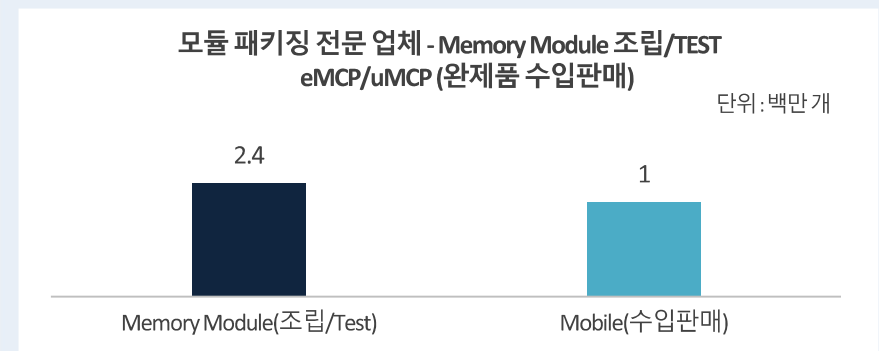


브라질 법인별 연간 CAPA

HT Micron



HE: HANA Electronics (2021년 7월 신설)



03. Major Overseas Affiliates(2) 베트남



해외 주요 법인, 경영 정상화 및 모바일/PC향 패키지 생산 확대로 실적 개선 전망

베트남 법인



입지 관련 장점

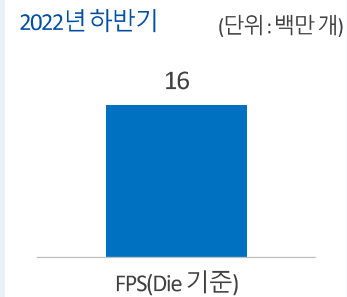
- 물류 공급 원활 (노이바이공항과 20분, 하이퐁항구와 1시간)
- 인력 공급 원활 (하노이 시내 1시간 거리)

저렴한 인건비

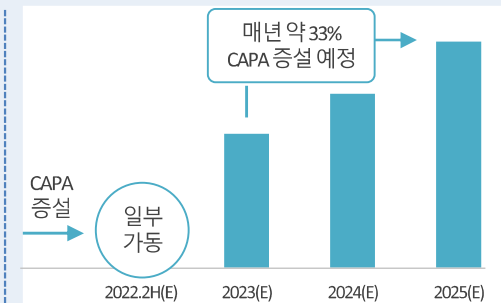


베트남 법인 연간 CAPA 및 생산 인력

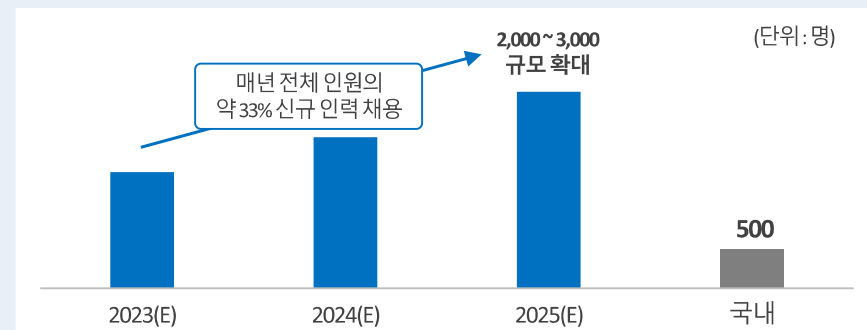
HANA Micron Vietnam (V1)



HANA Micron Vina (V2)



생산 인력 규모



Global Dream Company,
Realizing Dreams with the World
HANA MICRON INC.



Chapter 4.

Appendix

- 01. 요약 재무제표 (연결)
- 02. 요약 재무제표 (별도)

01. 요약재무제표 (연결)



연결재무상태표

단위: 억 원

구 분	2022	2023	2024	1Q25
유동자산	3,835	4,316	6,156	6,409
비유동자산	10,245	12,935	13,291	13,248
자산총계	14,090	17,251	19,446	19,656
유동부채	4,421	6,447	6,202	6,680
비유동부채	4,787	5,360	7,186	7,008
부채총계	9,208	11,807	13,388	13,689
지배기업소유주지분	2,641	3,091	3,716	3,657
자본금	240	240	331	331
기타불입자본	1,401	1,944	2,637	2,434
기타자본구성요소	231	305	427	449
이익잉여금	769	602	320	443
비지배지분	2,241	2,353	2,342	2,310
자본총계	4,882	5,444	6,058	5,968

주: K-IFRS 기준

연결손익계산서

단위: 억 원

구 분	2022	2023	2024	1Q25
매출액	8,944	9,680	12,507	3,118
매출원가	7,222	8,410	10,605	2,782
매출총이익	1,722	1,269	1,902	336
판매비와관리비	687	690	834	218
영업이익	1,035	579	1,068	117
기타영업외손익	92	(167)	(46)	95
금융손익	(232)	(272)	(1,041)	60
지분법손익	11	(0)	(2)	238
법인세비용차감전 순이익	907	140	(20)	(1)
당기순이익	582	10	(112)	6
지배기업소유주지 분	28	(135)	(238)	6

주: K-IFRS 기준